

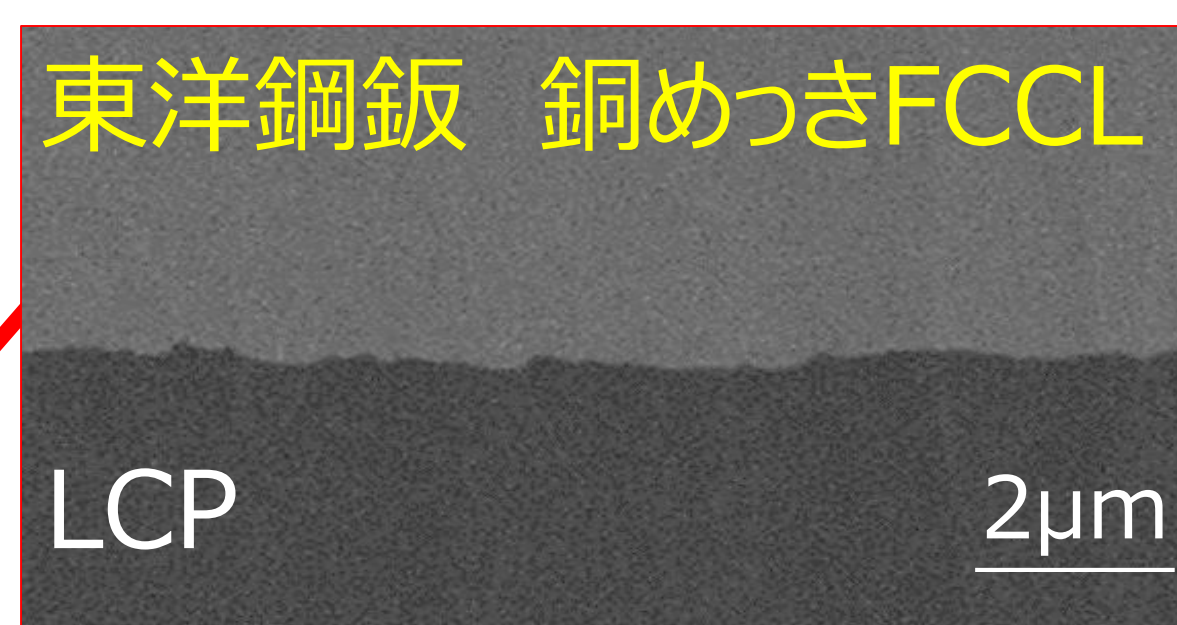
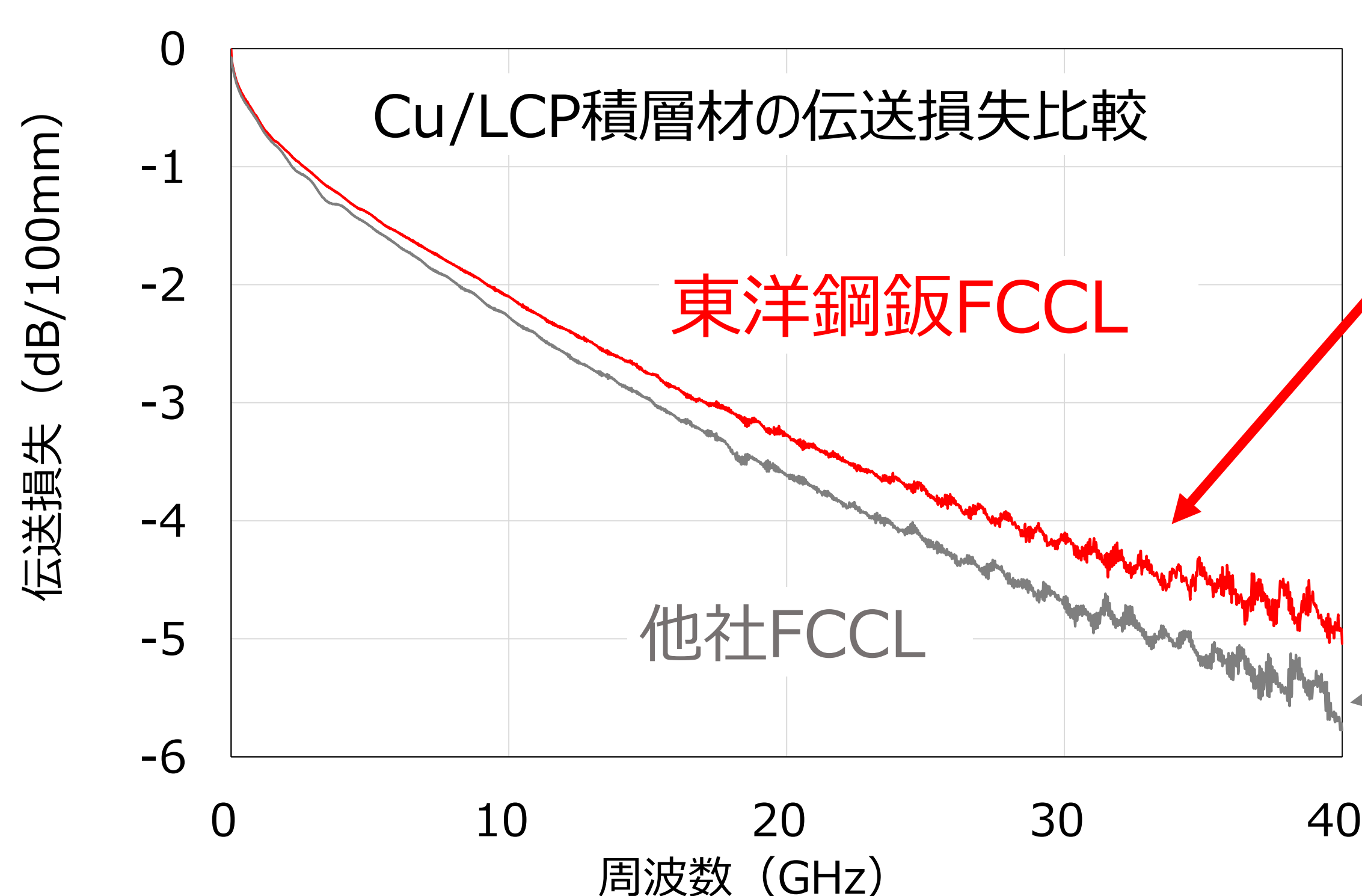
高速伝送に向けた東洋鋼鈑の取り組み

東洋鋼鈑では、高速伝送向け基板用材料のご提案を目指し
様々な素材を用いた開発に取り組んでいます。

伝送損失低減 = ①導体損失低減 + ②誘電体損失低減

①導体損失低減へのアプローチ

無粗化銅箔の積層あるいは、無電解めっき法による銅層形成による“平滑界面”の実現



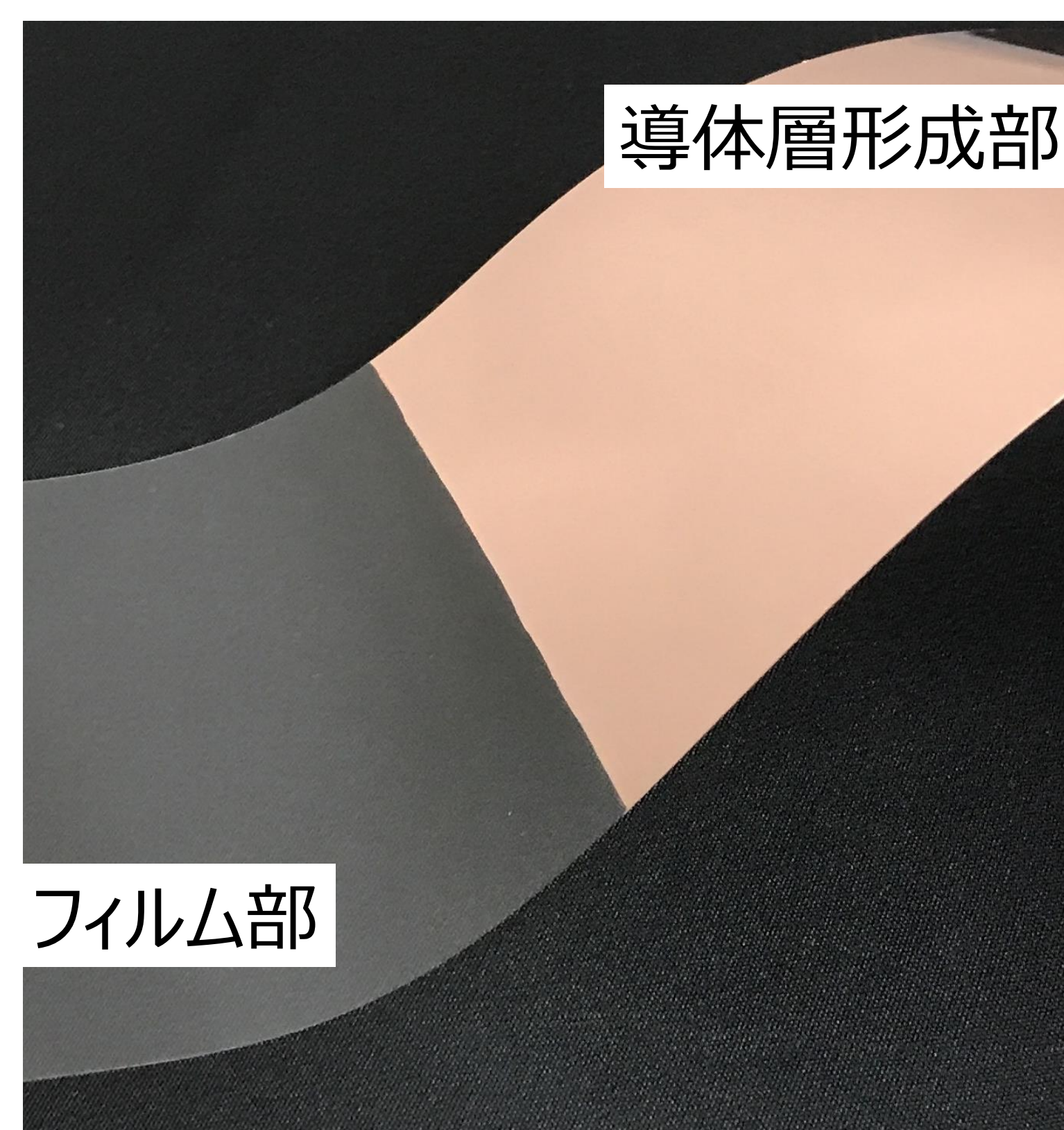
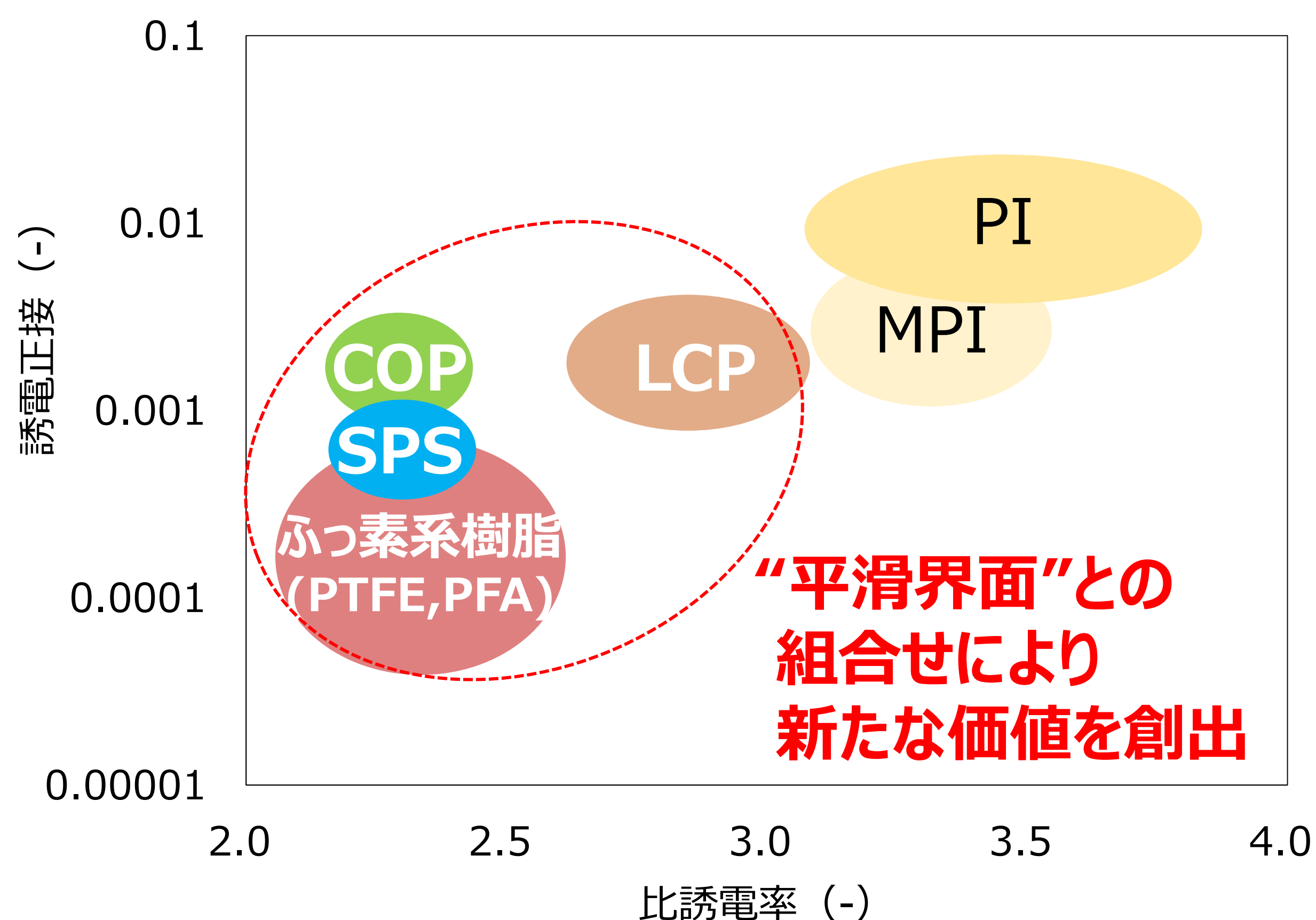
界面平滑



界面凹凸

②誘電体損失低減へのアプローチ

様々な“低誘電性フィルム”と“①平滑界面”の組合せ



COPベース材の試作例